

株式会社 **SCREEN** セミコンダクターソリューションズ

IoT向け電子デバイス市場のニーズに対応した検査・計測装置を開発 ～統合プラットフォームを採用した高精度・高生産性モデルをラインアップ～

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズはこのほど、デバイスの製造工程におけるさまざまなパターン検査に対応するウエハー外観検査装置「ZI-3500」、ウエハー表面に形成された超薄膜を高精度に測定する膜厚測定装置の上位機種「RE-3500」、そして光干渉式による非接触・非破壊での膜厚測定を特長とした「VM-3500」の3機種を開発。7月10日から、これらの装置の販売を開始します。



ZI/RE/VM-3500

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、
下記URLよりダウンロードできます。

(www.screen.co.jp/press/download/SPE170710-2.zip)

近年の半導体デバイスでは、継続的な微細化の進展に加え、モバイル機器やIoT向けデバイスをはじめとする旺盛な需要から、半導体製造プロセスの管理が一層重要な役割を果たしてきています。そのため検査・計測工程においても、微細なパターンをより高精度に検査・計測できる高信頼性だけでなく、量産に対応できる生産性の高い装置が求められています。

今回発売するパターン付きウエハー外観検査装置「ZI-3500」は、300mmまでのウエハーに対応する他、独自開発の1.0 μ m高解像度レンズを新たに採用し、より高精度な検査を可能にしました。また、従来比1.5倍となるハイスループットも実現しています。エリブソ式膜厚測定装置「RE-3500」は、マイクロスポット光学系の採用により、最小40 μ m角の微細なエリアを高精度に測定できるだけでなく、従来比2倍の高速測定が可能。そして、光干渉式膜厚測定装置「VM-3500」は、光干渉波形からスピーディーに多種多様な膜種の膜厚を測定でき、量産ラインの膜厚管理に最適です。いずれの機種も、従来モデルの優れた機能を継承しながら高精度と高生産性を実現した、コストパフォーマンスに優れた装置となっています。

そして、これら3機種は統合プラットフォームを採用。コンパクトな筐体でありながら100mmから300mmまでのウエハーサイズに対応し、FOUP、SMIF、オープンカセットなど多様な搬送機構の搭載が可能です。さらに、パーツの共通化による安定供給と短納期を実現します。

当社は、今回の「ZI-3500」、「RE-3500」、「VM-3500」のリリースによって検査・計測製品の充実を図り、今後ますます拡大が見込まれる半導体デバイス市場の発展に貢献していきます。

* これらの装置は、2017年7月11日(火)から13日(木)まで米国・サンフランシスコで開催される「SEMICON West 2017」でご紹介します。

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 社長オフィス 企画部 Tel: 075-417-2527 speinfo@screen.co.jp